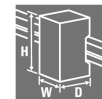
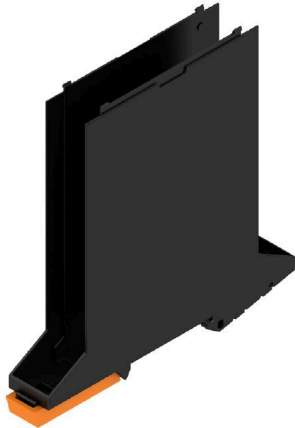


제품 이미지



모듈방식 CH20M 하우징의 기본 요소는 여러 가지 장점을 제공하여 프로젝트에 탁월한 선택입니다. 버스 및 FE 연락처를 위한 특수 컷아웃이 있어 특히 유연하고 적응력이 뛰어납니다.

또 다른 장점은 하우징에 레이저 인쇄 옵션이 있어 높은 정밀도와 개별 디자인 옵션을 제공한다는 것입니다. 다양한 색상도 사용 가능하여 원하는 대로 하우징을 디자인할 수 있습니다.

CH20M 하우징은 표준 조립 레일에 적합하기 때문에 기존 시스템에 설치하고 통합하는 것이 더 쉽습니다.

일반 주문 데이터

버전	모듈형 하우징, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 검정, 베이스 요소, 너비: 17.5 mm
주문 번호	1254130000
유형	CH20M17 B BK/OR 2010
GTIN (EAN)	4050118047103
수량	12 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	108 mm	깊이 (인치)	4.252 inch
높이	109.3 mm	높이 (인치)	4.3031 inch
너비	17.5 mm	폭 (인치)	0.689 inch
순중량	29.86 g		

온도

주변 온도	-25 °C...85 °C	작동 온도 범위	-40...120 °C
습도	5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66 GF 30
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	검정	보호 등급	IP20(설치 상태)
장착 레일	TS 35	컬러 차트(유사)	RAL 9011
캡슐화 옵션	아니요		

조립품 속성

장착 어셈블리 암형 커넥터용 슬롯 수, 최대	6	PCB 개수, 최대	1
결선 수준 수, 최대	3	극 수, 최대	18
PCB의 콤포넌트 높이, 최대	11.1 mm	PCB 어셈블리 유형	양면

열 테스트

열 시험	시험 조건	하우징 3개 연속 설치 - 간격 없음
	시험 액슬	수평
	주변 온도	80 °C
	전력 방출, 최대	0.9 W
	주변 온도	60 °C
	전력 방출, 최대	1.7 W
	주변 온도	40 °C
	전력 방출, 최대	2.45 W
	주변 온도	20 °C
	전력 방출, 최대	3.2 W

기술 데이터

부품 속성

클립온핏 색상	주황색	결선 수준 수, 최대	3
---------	-----	-------------	---

디자인 - IN 요구 사항

PCB 형태에 대한 공차	±0.1 mm	PCB 두께	1.6 mm
회로 보드 두께의 공차	±0.15 mm		

개별화 옵션

고객 맞춤 라벨 표시 가능	예	고객 특정적 주문 절차	다운로드 아래 지침 참조
대체 색상	요청 시 추가	처리 가능성	레이저 가공

중요 참고 사항

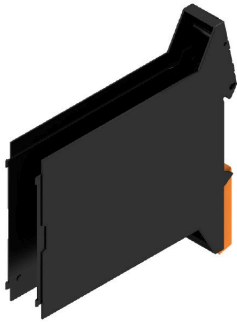
제품 정보	회로기판 윤곽, 제한 구역 및 그 외 회로기판 설계 관련 정보는 다운로드 섹션의 해당 수형 헤더 아래의 결선 기술 카테고리에서 확인하실 수 있습니다.		
-------	---	--	--

분류

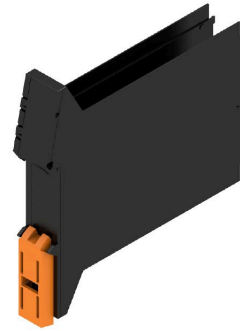
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

도면

제품 이미지



제품 이미지



발 부분 스냅인에 컷아웃 없는 베이스 요소

치수 도면

